

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-05

| | |
|---------------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名（排名不分先后） | 开源证券、台湾统一证券、上投摩根、台湾东腾投资、天风证券、太平洋证券、国金证券、上海证券等 |
| 时间 | 2021年4月14-19日 |
| 地点 | 电话会议、深圳南山区侨城东路99号深南电路股份有限公司5楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流主要内容：</p> <p>Q1、公司一季度归母净利润变动原因。</p> <p>受通信市场调整的影响，公司产能利用率较同期下降，单位固定成本分摊增加；产品结构调整，低毛利产品较同期增加；此外，公司在汽车、存储等方面的研发投入增加。环比来看，主要受春节因素及原材料价格上升的影响。</p> <p>Q2、公司一季度研发费用主要投入方向。</p> <p>公司为配合无锡基板项目及南通三期专业汽车生产线建设，一季度研发费用主要投向存储及汽车电子领域。</p> <p>Q3、请介绍公司各业务当前产能利用率情况。</p> <p>目前公司PCB、PCBA业务综合产能利用率在春节后较前期有所提升，封装基板业务产能利用率持续保持较高水平。</p> |

Q4、目前公司原材料供给方面是否存在压力？

公司作为原材料供应商战略客户，在原材料供给上能够获得一定保障。公司加强与供应商、客户的沟通协商，共同面对材料价格上涨压力，努力实现共赢。

Q5、公司 PCB 业务在各市场领域占比情况如何？

公司 PCB 业务目前以通信市场为主，数据中心、工控医疗、汽车电子等相对分散，其中数据中心、汽车电子业务增速较快，占比持续提升。

Q6、公司对 2021 年通信市场如何展望？

根据工信部信息显示，我国 2021 年计划新建 5G 基站 60 万个，在实现地级以上城市深度覆盖的基础上，加速向有条件的县镇延伸。公司目前通信类产品以 700M 项目产品为主，随着后续 5G 需求逐步释放，通信市场需求预计会有所回升。

Q7、公司目前是否有布局消费电子领域？

目前公司 PCB 业务产品较少涉及消费电子领域，与消费电子领域相关的主要为封装基板业务，如公司封装基板产品 MEMS-MIC 产品广泛应用于消费电子产品中。

Q8、公司汽车电子业务所面向的客户类型。

公司汽车电子业务主要聚焦 ADAS 和新能源汽车方向，主要面向 TIER1（车厂一级供应商）客户，公司也会参与整车厂部分研发项目合作。

Q9、公司汽车电子业务客户认证情况。

公司已积极投入汽车电子相关技术研发，积累生产能力，并与国内外部分知名厂商开展合作，南通一期及深圳基地均可承接生产部分汽车电子产品；为配合南通三期汽车专业生产线的建设，满足公司拓展汽车电子业务的经营策略，公司已从去年开始加大客户认证力度。

Q10、公司如何看待封装基板市场前景以及自身封装基板业务的发展？

| | |
|------|---|
| | <p>从国内产业链配套来看，封装基板作为集成电路产业链中的关键一环，存在广阔的市场机会；从全球产业格局上看，国际上主流封装基板厂商以日本、我国台湾地区和韩国为主，在国内集成电路快速发展的环境下，封装基板产业仍有较好的发展前景；从公司本身来看，公司拥有进入该领域的先发优势。从目前投入产能来看，公司在深圳拥有两个封装基板工厂，产能规模相对较小。无锡基板工厂目前爬坡进展顺利，达产后产能预计 60 万平方米/年，并且仍可通过技改等方式进一步提升产能。</p> <p>Q11、公司如何看待当前存储类封装基板市场产能紧缺的情况。</p> <p>从产能投入来看，存储类封装基板在 2019 年之前，需求相对疲软，在公司发展存储类封装基板业务期间，业内其他厂商投向该领域的产能相对较少。因此，伴随着市场需求回暖，存储类封装基板产能处于供应紧张的状态。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021 年 4 月 20 日 |